

证券代码：301348

证券简称：蓝箭电子

## 佛山市蓝箭电子股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2024-003

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	国泰君安：舒迪、刘校、龙小琴
时间	2024年8月30日
地点	佛山市禅城区古新路45号佛山市蓝箭电子股份有限公司5楼会议室
上市公司接待人员姓名	1、董事、副总经理、董事会秘书张国光 2、证券事务代表林品旺
投资者关系活动主要内容介绍	<p>投资者提出的问题及公司回复情况：</p> <p>1、公司产品下游结构拆分情况。 答：公司从事半导体封装测试业务，为半导体行业及下游领域提供分立器件和集成电路产品。从产品下游应用领域看：公司产品主要应用于消费类电子为主；其次包括电源领域、工业控制、智能家居、安防、网络通信、汽车电子等多个领域，多年来公司与客户建立了长期稳定的合作关系。目前整个电子行业中汽车电子领域受益于新能源汽车的普及，景气度相对较好，市场需求持续增长。随着信息技术的快速发展，未来物联网、人工智能、通讯网络及汽车行业的更新迭代，公司将持续研发投入、积极技术创新，在工业类、车规级产品研发、氮化镓快充等多项前沿技术领域开发新的产品，为公司未来收入增长提供有力支持。</p> <p>2、公司在2024年及未来的发展方向。 答：随着大电流、高电压等应用场景需求增长，功率器件产品需求持续旺盛，应用了Clip bond等技术的产品封装系列能够更好的满足市场对大电流、高电压等功率器件的要求，在工业控制、新能源汽车等领域广泛得到应用。公司紧密围绕大电流、高温、高功率器件封装技术开展研发，已形成功率器件封装的核心技术，在功率器件封装的粘片、压焊等多个环节不断创新。同时，在芯片级贴片封装技术（DFN/QFN封装）方向：公司分立器件封装顺应行业发展趋势，逐步向小尺寸封装、高功率密度方向发展。</p> <p>3、蓝箭电子未来增长动力，成本管控情况。</p>

	<p>(1)关于未来增长动力</p> <p>答：公司围绕募投项目半导体封装测试扩建项目和研发中心建设项目的正常推进，将会继续加大在研发方面的投入，扩充产品线；在现有核心技术的基础上，公司将顺应半导体封装测试小型化、集成化的发展趋势，进一步开拓新产品、新技术的应用方向。随着研发中心建设项目的推进，将会扩大研发中心实验基地，购置研发、测试设备，增加团队规模，形成更加完善的半导体封装测试研发、生产体系。</p> <p>同时，公司注重人才的引进和培养，逐步建立了较为完善的人才引进与培养机制，采取多元化的薪酬激励体系，促进内部竞争，培养专业化人才队伍。加强与各大高校合作招聘，推行产学研结合机制并寻求外部研发合作等方式吸收专业技术人才，通过各种方式补充相应的人才以适应公司不断发展的需要。</p> <p>(2)成本管控情况</p> <p>答：公司在数字化、智能制造领域目前已开展全部产线设备数字化管理和自动搬运管理推动升级。公司已经引入应用机器人封装技术、AI智能管理、制造业大数据分析系统等，目前已通过自主创新在封测全流程实现智能化、自动化生产体系的构建，实现了供、产、销、研有机互联，能够从订单接收到产品出库实现全流程质量控制和实时监测，实现全流程的智能互联。未来，随着国内半导体生产技术持续提升，公司将继续推进和实现半导体生产设备、生产材料的国产化替代进程。</p> <p>4、公司二季度单季度的毛利率比一季度有提升的原因。</p> <p>答：二季度的提升，主要是公司在内部控制方面做了大量工作，通过提高内部效率、提升产能利用率，降低材料、配件和能耗等措施来提高毛利率。</p> <p>5、关于公司并购的考虑</p> <p>答：公司在做大做强半导体封装测试主业的基础上，也会考虑通过资本运作延伸产业链条，集中配置资源，围绕上下游及新兴产业开展并购和股权投资扩大发展规模；后续如有相关事项会按照相关法律法规及时披露。谢谢。</p> <p>6、对行业的发展方向的想法</p> <p>答：随着全球经济回暖和下游需求的传导，半导体产业所具有的广阔市场前景和增长潜力将会进一步得到释放。预计今年下半年至明年年初，行业价格有机会继续回暖；但消费欲望普遍收缩，也有可能令行业发展持续承压。总体上，目前市场需求还在逐步恢复过程中。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年8月30日